

(上接13版)

本次发行后公司总股本为287,823.7397万股(超额配售选择权行使前),若超额配售选择权全额行使,则发行后公司总股本为295,513.3397万股(超额配售选择权全额行使后)。

本次发行初始战略配售发行数量为25,632.3000万股,占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的50.00%,约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。本次发行战略配售者承诺的认购资金已及时足额缴纳至联席主承销商指定的银行账户。根据最终确定的发行价格,本次发行最终战略配售数量为25,632.3000万股,占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的50.00%,约占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的43.48%。初始战略配售股数与最终战略配售股数相同,本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

网上、网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,网下初始发行数量为20,506.0000万股,约占超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售数量后初始发行数量的80.00%,约占超额配售选择权全额行使后、扣除最终战略配售数量后本次发行总量的61.54%;网上、网下回拨机制启动前、超额配售启用前,网上初始发行数量为5,126.3000万股,约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后本次发行总量的20.00%,网上、网下回拨机制启动前、超额配售启用后,网上初始发行数量为12,815.9000万股,约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的38.46%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

6、网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

7、本次发行网上网下申购于2026年9月24日(T日)15:00同时截止。网上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2026年9月24日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、(五)回拨机制”。

8、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》,于2026年9月29日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于2026年9月29日(T+2日)16:00前到账。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股,请按每只新股分别足额缴款。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按照规范填写备注。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生

的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上摇号中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2026年9月29日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,本次发行因网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐人(联席主承销商)广发证券包销。

9、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列人限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

10、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

11、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读2026年9月23日(T-1日)披露的《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”),充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。

12、发行人和联席主承销商承诺,截至本公告发布日,不存在影响本次发行的重大事项。

有关本公告和本次发行的相关问题由联席主承销商留最终解释权。

估值及投资风险提示

1、本次发行价格为12.01元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至2026年9月18日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平

均静态市盈率为73.18倍,请投资者决策时参考。

截至2026年9月18日(T-4日),《招股意向书》中披露的同行业可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-4日 股票收盘价 (元/股)	T-4日 市值 (亿元)	2025年营业收入 (亿元)	对应市销率 (倍)
688981.SH	中芯国际	122.00	10,445.96	673.23	15.52
688347.SH	华虹公司	234.00	4,512.68	172.91	26.10
688468.SH	芯联集成-U	8.72	730.97	81.80	8.94
688249.SH	晶合集成	36.75	821.28	108.85	7.54
688172.SH	燕微	46.91	669.70	18.33	36.53
平均值(剔除极值)					14.52

数据来源:Wind资讯,数据截至2026年9月18日(T-4日)。
注1:市销率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
注2:市销率平均值计算剔除了极值(燕微)。

本次发行价格12.01元/股对应的发行人未行使超额配售选择权时2025年摊薄后静态市销率为13.39倍,若全额行使超额配售选择权后本次发行后市销率为13.74倍,低于可比上市公司2025年静态市销率平均水平,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险,投资者应充分了解创业板市场的投资风险及《招股意向书》中披露的风险因素,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

本次发行定价合理性说明如下:
与行业内其他公司相比,粤芯半导体在以下方面存在一定优势:

①平台优势:“集成电路、功率器件、光电融合”三位一体的产业布局

公司主要从事集成电路制造环节中的12英寸晶圆代工业务,具备集成电路、功率器件等多元化产品平台的工艺研发与制造能力,涵盖MS、HV、CIS、BCD、eNVM、MOSFET、IGBT、SiPho等工艺技术平台。公司成立以来,紧密贴合模拟芯片行业品类多样化的产品特点,持续丰富自身产品组合,目前已具备较完整的成熟节点工艺制程,可为客户提供180~55nm等多个制程节点的特色晶圆代工服务,产品应用领域覆盖消费电子、工业控制、汽车电子和人工智能等。

在技术创新方面,公司于2024年底成功推出12英寸90nm SiPho工艺技术平台。截至本公告签署日,公司的硅光工艺技术平台累计投产量已超过7,000片;根据Frost & Sullivan数据,截至2026年4月末,公司是中国大陆唯一具备12英寸硅光晶圆大规模量产能力的企业。公司的硅光产品涵盖400G、800G及1.6T高速可插拔硅光光模块应用,与国际领先水平相当。同时,公司与业界先进水平保持同步,开展近封装光学(NPO)的工艺制造技术研发,目前正在导入3.2T NPO产品。未来,公司将进一步开展65nm

(上接13版)

⑤质量管理体系优势:构筑完备的认证体系,保障市场口碑

公司已通过ISO 9001、ISO 50001、ISO 14001、ISO 45001等国际质量管理体系认证;瞄准车规产品产线质量控制要求,建立完善的生产参数控制及质量控制系统、失效模式与影响分析机制(FMEA),并已通过车规生产线质量管理体系IATF 16949认证;按照国际权威的德国汽车工业联合会过程审核标准VDA6.3要求,系统性构建面向车规级芯片的全生命周期质量管理体系。

一系列完备的质量管理体系和严格的质量控制标准,提升了公司生产经营的规范化水平,保障了公司晶圆代工服务的产品良率和交付质量,有助于公司建立和维护良好的市场口碑和品牌形象,获得客户的高度认可。

⑥客户优势:携手境内外芯片设计龙头企业,夯实客户基础

公司自成立以来一直致力于客户资源的拓展与积累,主要客户涵盖境内外多家半导体行业上市公司和龙头企业,凭借多元化产品平台的工艺研发与制造能力,获得了市场的高度认可与良好的行业口碑。截至2025年12月31日,公司累计开发客户超过200家,覆盖境内外上市公司近40家,包括全球领先的芯片设计公司及多家细分领域行业龙头企业:全球第一大指纹识别芯片设计公司、全球第一大电子标签芯片设计公司、全球出货量第二大的图像传感器芯片设计公司、全球前三大独立智能手机芯片设计公司中的两家、中国第一大MCU芯片设计公司,以及多家显示驱动芯片、电源管理芯片及功率器件上市公司。在公司重点聚焦的模拟芯片领域,国内前十大模拟芯片上市公司合作覆盖率80%。

基于对公司研发能力、技术平台、产能支持、产品品质、服务配合度的认可,行业龙头企业与公司建立并维持了良好的合作关系。坚实的客户基础,推动公司产品平台的技术迭代和技术积累,不断提升经营业绩和盈利能力。

(2)根据本次发行确定的发行价格,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为341家,管理的配售对象数量为10,812个,占剔除无效报价后所有配售对象总数的95.72%;有效拟申购数量总和为58,733,090万股,占剔除无效报价后申购总量的97.00%,为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的2,864.19倍。

(3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)、中国金融新闻网(www.financialnews.com.cn)、经济参考网(www.jckb.cn)、中国日报网(www.chinadaily.com.cn)的《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。

(4)《招股意向书》中披露的募集资金需求金额为750,000.00万元。按本次发行价格12.01元/股计算,超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为615,687.85万元,若超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为708,039.94万元,低于前述募集资金需求金额,请投资者注意筹资金额不能满足使用需求的风险。

(5)本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人与联席主承销商根据初步询价结果情况并综合考虑余价及拟申购数量、有效申购倍数、发行人基本面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行价格(12.01元/股)不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价的中位数和加权平

均数孰低值(13.1669元/股)。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何疑问,建议不参与本次发行。

(6)本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,如晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

8、按本次发行价格12.01元/股计算,超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为615,687.85万元,扣除约19,461.39万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额为596,226.46万元。若超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为708,039.94万元,扣除约21,819.56万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额为686,220.39万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平和股东长远利益产生重要影响的风险。

9、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

本次网下发行部分采用约定限售方式,安排网下发行证券设定不同档位的限售比例或限售期。发行人和联席主承销商协商确定本次的限售档位为三档:(1)档位一(投资者报价时对应申报限售期9个月,限售比例60%);网下投资者应当承诺其获配股票数量的60%(向上取整计算)限售期限自发行人首次公开发行并上市之日起9个月;(2)档位二(投资者报价时对应申报限售期6个月,限售比例40%);网下投资者应当承诺其获配股票数量的40%(向上取整计算)限售期限自发行人首次公开发行并上市之日起6个月;(3)档位三(投资者报价时对应申报限售期6个月,限售比例20%);网下投资者应当承诺其获配股票数量的20%(向上取整计算)限售期限自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算,其余获配股份无流通限制及锁定安排,上市首日即可交易。

公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险资金、保险资产管理产品和合格境外投资者资金(A类投资者)可以自主申购上述三种档位中的不同限售档位,其他投资者(B类投资者)仅可申购档位三。申购限售档位为投资者在初步询价阶段提交的限售比例,如申购阶段与初步询价阶段提交限售档位不一致,将以初步询价阶段为准。限售期自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起开始计算。

在参与网下申购时,网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格、申购数量和申购限售档位(包括“限售期”和“限售比例”)。一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期和限售比例安排;如果申购档位一、档位二的投资者较少,初步配售后无法满足整体限售比例要求,则发行人和联席主承销商将相应提高档位三的限制比例,直至满足网下发行部分整体限售比例不低于40%。对于选择档位三的网下投资者,其最终限售比例及限售期限以《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)披露的内容为准。

战略配售方面,全国社会保障基金理事会(委托广发基金管理有限公司管理的“全国社保基金四一四组合”、易方达基金管理有限公司管理的“基本养老保险基金一二零五组合”、银华基金管理股份有限公司管理的“基本养老保险基金六零一二组合”以及大成基金管理有限公司管理的“全国社保基金四一组合”)获配股票的限售期为18个月,实施跟投的保荐人相关子公司以及其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期均为24个月,发行人高级管理人员与核

硅光及光电融合工艺的研发和量产,实现从可插拔光模块向近封装光学(NPO)、光电共封装(CPO)的演进,以满足市场对硅光及光电融合芯片在制造技术及代工产能上的急迫需求。公司是国内极少数能够同时提供“集成电路、功率器件、光电融合”三位一体工服务的集成电路制造企业。

②模式优势:打造“终端、设计与制造”的协同优化模式
晶圆代工作为半导体行业垂直化、专业化分工的关键环节,是半导体制造产业的核心构成。标准化工艺的晶圆代工模式在数字芯片等领域具备显著的效率和成本优势,但对模拟芯片并非最优。其主要原因在于模拟芯片的性能(如低失真、高信噪比、可靠性与稳定性)更依赖于工艺创新与器件优化,而非仅通过制程尺寸缩减,需通过特色工艺与设计的深度融合实现。

公司坚持特色工艺路线,基于丰富的产品组合、深厚的技术积淀,能够以高质量的标准,开发具有市场竞争力的工艺技术平台。同时,公司深度协同芯片设计公司及终端客户,推动终端、设计与制造协同优化的创新模式,共同探讨工艺制造与设计优化的解决方案,积极帮助客户实现其特定设计目标和工艺需求,增加其产品差异化和竞争力,逐步突破国内高端模拟、数模混合、硅光及光电融合芯片的技术瓶颈。该合作模式增强了客户粘性,提升了公司的品牌影响力,奠定了公司未来持续快速发展的基础,是公司市场竞争优势的重要体现。

③区位优势:践行“终端牵引设计、设计带动制造”的创新思路

粤港澳大湾区是全国乃至全球电子产业终端厂商最集中的区域之一,汇聚智能移动终端、新一代电子信息、新能源汽车、智能机器人、超高清视频显示、智能家电等万亿级产业集群,拥有从芯片设计、终端制造到市场应用的完备产业链基础。随着全球产业链的重构,中国厂商在智能移动终端、汽车电子、智能机器人、人工智能等高科技领域的重要性逐渐凸显,终端定义需求,终端牵引设计,已经逐渐成为产业协同推动创新技术商业落地的高效转化模式。

公司发挥贴近终端客户,掌握市场动态,积极构建生态的区位优势,通过深度协同区域内的上游集成电路设计厂商与下游终端应用企业,打造紧密的产业联盟,打通从设计到制造、再到应用的关键环节,以高效协同、快速响应的服务模式,灵活的经营策略和充分的产能支持,满足客户的多样化需求,激发产业的创新活力。

公司与总部位于大湾区的全球指纹识别芯片龙头企业紧密合作,成功攻克硅基超声波指纹识别芯片的制造技术难题,实现了国内该领域的技术突破,打破境外厂商在该领域长期垄断地位,使公司成为国内少数具备硅基超声波指纹识别芯片大规模量产能力的晶圆代工厂之一。目前,该创新方案已成功导入VIVO、OPPO等多家扎根大湾区的知名手机品牌。

④人才团队优势:国际化专业人才梯队与市场化管理机制,打造竞争活力

(下转15版)

认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

16、本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期活期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

17、本次发行前的股份有限限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规作出的自愿承诺。

18、中国证监会、深交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

19、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及联席主承销商将协商采取中止发行措施:

(1)网下申购总量小于网下初始发行数量的;
(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;
(3)扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%;
(4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行;

(5)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令(第228号))和《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2026年修订)》(深证上(2026)552号),中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行人、联席主承销商、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和联席主承销商将择机重启发行。

20、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2026年9月15日(T-7日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)、中国金融新闻网(www.financialnews.com.cn)、经济参考网(www.jckb.cn)、中国日报网(www.chinadaily.com.cn))的《招股意向书》全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

21、发行人、联席主承销商郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。

22、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:粤芯半导体技术股份有限公司
保荐人(联席主承销商):广发证券股份有限公司
联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司
2026年9月23日